



团 体 标 准

T/CEMIA 037—2023

厚膜集成电路用银钯导体浆料规范

Specification for Ag/Pdconductor paste for thick film integrated circuits

2023-11-14 发布

2023-12-30 实施

中国电子材料行业协会 发 布
中 国 标 准 出 版 社 出 版

前 言

本文件按照 GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第 1 部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利，本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中国电子材料行业协会提出并归口。

本文件起草单位：西安宏星电子浆料科技股份有限公司、中国电子科技集团公司第四十三研究所、中国兵器工业集团 214 所、青岛航天半导体研究所有限公司。

本文件主要起草人：鹿宁、张艳萍、王顺顺、赵莹、白碧、董永平、尤广为、孙华涛、谢广泽。

厚膜集成电路用银钯导体浆料规范

1 范围

本文件规定了厚膜集成电路用银钯导体浆料的产品分类、技术要求、检验方法、检验规则及包装、标志、运输、贮存。

本文件适用于由导电相、玻璃相、有机载体以及添加剂组成的能满足印刷特性的厚膜集成电路用银钯导体浆料(以下简称:银钯导体浆料)。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中,注日期的引用文件,仅该日期对应的版本适用于本文件;不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 17473.6—2008 微电子技术用贵金属浆料测试方法 分辨率测定

GB/T 17473.7—2022 微电子技术用贵金属浆料测试方法 第7部分:可焊性、耐焊性测定

GJB 548C—2021 微电子器件试验方法和程序

SJ/T 11512—2015 集成电路用电子浆料性能试验方法

T/CEMIA 021—2019 厚膜集成电路用电阻浆料规范

3 术语和定义

T/CEMIA 021—2019 界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1

厚膜集成电路用银钯导体浆料 **Ag/Pd conductor paste for thick film integrated circuits**

由导电相、玻璃相、添加剂以及有机载体组成的一种满足于印刷特性的膏状物。

3.2

方数 (Square number)

浆料烧结膜图形的长/宽比值,单位符号用“□”表示。

[来源: T/CEMIA 021—2019,3.1]

4 分类与标记

4.1 分类

根据银钯导体浆料的导电相中,银钯所占的质量分数不同进行分类。